



Programm Deutsche IMAPS-Konferenz 2008

14./15. Oktober 2008, Hochschule München, Gebäude R, Lothstr. 64, 80335 München (Nähe Hauptbahnhof)

Dienstag, 14. Oktober 2008

<i>Thema</i>	<i>Vortragender Firma, Ort der Firma</i>
12:00 Einschreibung	
13:00 Konferenzöffnung	Vorsitzender IMAPS-Deutschland
13:10 Thick film pastes for the manufacture of low cost, insulated aluminium substrates for use as integrated heat sinks for high intensity LED	John Whitmarsch ESL, Berks, UK
13:35 Gießen von keramischen Folien mit UV- Vernetzung	Rainer Ronniger Karo, München
14:00 Entwicklung niedrigsinternder Funktionswerkstoffe für LTCC- Anwendungen	Stefan Barth HITK, Hermsdorf (Thür.)
14:25 Elektrochemische Sensoren in Dickschichttechnik	Kathrin Reinhardt IKTS, Dresden
14:50 Aussteller stellen sich kurz vor (jeweils 2 min)	
15:20 Kaffeepause	
16:00 Zuverlässigkeit bleifreier Lötverbindungen für Automotive- Anwendungen: Neue Bewertungskriterien mittels Korrelation unterschiedlicher Analyseverfahren	Antje Steller (Schafföner) VW, Wolfsburg
16:25 Zuverlässigkeit von Keramik-Mikrowellen-Packages für Raumfahrtanwendungen	Matthias Mach TU Ilmenau
16:50 Stressmesssystem zur Untersuchung von verpackungsbedingtem Stresseintrag auf mikroelektronischen Bauelementen	Hartmut Kittel Bosch, Heilbronn / Abstatt
17:15 Ende der Vorträge	
17:20 Mitgliederversammlung	
19:30 Geselliger Abend beim Augustiner	

Mittwoch, 15. Oktober 2008

09:00	Lotbumperzeugung mit Durchmessern von 100 µm mit Bi- und In-haltigen Lotlegierungen	Stefan Kemethmüller MSE, Berg
09:25	Beyond 3D Manufacturing process development for multi material wafer scale packaging	John Sweet Loadpoint Ltd., Swindon, UK
09:50	Einsatz der polymeren Dickschichttechnik für ein Wafer Level Package in Drucktechnik	Marco Luniak TU Dresden
10:15	Großflächige Elektronik-Integration	Karlheinz Bock TU Berlin
10:40 Kaffeepause		
11:20	Prozessintegrierte Qualitätskontroll-Methode zur Überwachung der Bondqualität	Klaus Schrimper Hesse & Knipps, Paderborn
11:45	Elektrische Charakterisierung und Bewertung von AVT-Materialien	Uwe Maaß IZM Berlin
12:10	Optoelektronischer Neigungssensor	Andreas Albrecht CiS Erfurt
12:35 Mittagspause		
13:40	Aktuelle Trends in der Dünnschichttechnik	Alexander Kaiser RMT-Microtech, Ulm
14:05	Packaging von RF-MEMS-Schaltern mit Glasdeckel und UV-härtendem Kleber	Bernhard Schönlinner EADS, München
14:30	Mischbestückung von COB und SMT – AVT in der industriellen Praxis	Alexander Ferber Aemtec, Berlin
14:55	Fertigung elektronischer Baugruppen für die Automobilelektronik	Horst Pölloth BMW, München
15:20	Schlussworte	Vorsitzender IMAPS-Deutschland
15:30 Ende der Veranstaltung		

IMAPS Japan 2008

10./12. Juni 2008, Big Sight Konferenz- und Messezentrum, Tokio, Japan

Bereits zum achten Mal fand vom 10. bis 12. Juni in Tokio die *IMAPS Japan* statt. In Japan wird *IMAPS* durch das *JIEP (Japan Institute of Electronics Packaging)* organisiert, weiterhin ist *IEEE CPMT* Sponsor der Veranstaltung. Die japanische Konferenz ist auch der Treffpunkt von Fachkollegen u.a. aus Korea, China, Singapur, Malaysia, Taiwan und Indien, die zum Teil keine jährlichen Veranstaltungen in ihren Chapters abhalten. Bei der nunmehr jährlichen Konferenz kommen außer den Experten des asiatischen Raumes auch solche, die, aus der fernöstlichen Sichtweise gesehen, von Übersee



Das Veranstaltungsgebäude „Big Sight“



Die Awarding Ceremony



Ein Blick ins Auditorium

Tagungen und Konferenzen

Call for Papers für die „IMAPS/ACerS 5th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT)“

Die nächste *CICMT* wird vom 20. bis 23. April 2009 in Denver/Colorado stattfinden. Tagungsort ist das *Curtis Hotel*. Die Veranstaltung beinhaltet außer der eigentlichen Konferenz eine Ausstellung und eine Postersession mit hauptsächlich studentischen Arbeiten. Neueste technische Entwicklungen und Trends werden auch von eingeladenen Sprechern in Keynote-Presentations vorgestellt.

Thematische Schwerpunkte sind *Ceramic Microsystems*, *Ceramic Interconnect* und *Advanced Packaging Technology*, wobei jeweils das gesamte Spektrum von Design, Simulation, Technologie bis hin zu Umweltaspekten und Marketing abgedeckt wird.

Abstracts im Umfang von 250 - 300 Worten sind bis zum **21. November 2009** auf elektronischem Weg in englischer Sprache einzureichen.

www.cicmt.org

32nd International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference

Die jährlich stattfindende polnische IMAPS-Konferenz wird in diesem Jahr von der *Technischen Universität Warschau (Institut für Materialien der Elektronik)* unter Beteiligung der *Akademie der Wissenschaften* organisiert und findet vom 21. bis 24. September in Pultusk, etwa 60 km von Warschau entfernt, statt. Erstmals ist

kommen, zusammen. Die diesjährige Veranstaltung hatte über 250 Besucher, wobei eine zeitlich überlappende Messe zusätzlich für Synergie sorgte. Das Konferenz- und Messezentrum *Big Sight* bietet im 6. Stockwerk des futuristischen Eingangsgebäudes, das die Form von vier auf dem Kopf stehenden Pyramiden hat, sowohl genügend Platz für die Räume, in denen die 3 parallelen Sessions stattfanden, als auch für Besprechungen und Vorbereitung sowie die Posterpräsentation. Einen hohen Stellenwert hat die Awarding Ceremony, in der neben den Awards für die besten Paper und Poster auch Junioren-Awards an Vortragende unter 35 Jahren vergeben wurden.

Während der Veranstaltung fand auch ein ALC-Meeting statt. Ein wesentlicher Punkt waren hierbei sicherlich organisatorische Abstimmungen für die 2010 in Japan und damit nach München 2008 zum zweiten Mal außerhalb der USA stattfindende *CICMT*

es eine gemeinsame Veranstaltung mit der *IEEE CPMT Polens*. Auch in diesem Jahr hat man wieder einen sehr stimmungsvollen Austragungsort, ein Schloss aus dem 15. Jahrhundert, ausgewählt.

Die Themenschwerpunkte sind:

1. Hybrid and Semiconductor Technology
2. Design Methods and Computer Simulations
3. Electronics Materials and Components
4. Microcircuits Applications
5. Thick-Film and Thin-Film Sensors
6. Packaging and PCB
7. Quality and Reliability Evaluation
8. Thermal Management
9. Optoelectronics and Photovoltaics
10. Education in Electronics

Traditionell wird bei dieser Konferenz großer Wert auf eine umfangreiche Postersession gelegt, daneben findet eine Reihe von Vorträgen eingeladenen Sprecher statt.

<http://imaps2008.imio.pw.edu.pl/>

NAMICS CORPORATION



NAMICS CORPORATION mit Sitz in Niigata-City, Japan, ist Hersteller von Microelectronic Packaging- und Assembly-Materialien, sowie Materialien für die Herstellung von Passiven Komponenten.

NAMICS wurde 1947 als Hersteller von Druckfarben gegründet. In den

frühen 80er Jahren erfolgte ein Richtungswechsel hin zu Pasten für die Elektronik. Anfänglich wurde hauptsächlich der asiatische Markt bedient, heute ist *NAMICS* ein global agierendes Unternehmen und weltweit vertreten.

NAMICS weist seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum auf und erreichte im Jahr 2006 einen Umsatz von 100 Mio. €. Heute beschäftigt *NAMICS* über 450 Mitarbeiter von denen ca. 100 im Bereich F&E tätig sind.

Es ist erklärtes Ziel des Unternehmens, als einer der führenden Hersteller für die folgenden Materialien wahrgenommen zu werden: Chipabdeckmaterialien; Underfiller, Die Attach Kleber, strukturelle Kleber für optische Sensoren sowie leitfähige Kleber als Lotersatz; des weiteren für keramische Pulver, Dickschichtpasten und Polymerbasierende Silberpasten zur Herstellung von Multilayer-Chip-Kondensatoren und anderen passiven Bauelementen.

Darüber hinaus entwickelt *NAMICS* spezielle Produkte wie z.B. metallorganische Silberpasten oder dielektrische Filme mit niedriger dielektrischer Konstante und niedrigerem Verlustfaktor – das sind Produkte, welche in zukünftigen Technologien Verwendung finden werden.

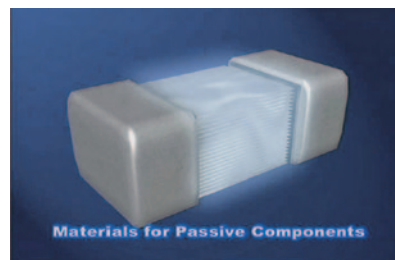
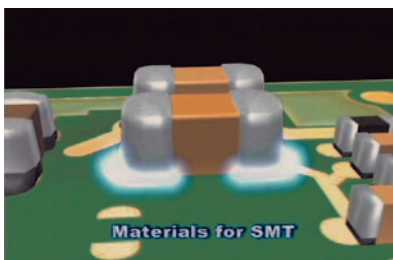
Eine der wichtigsten Eigenschaften von *NAMICS* jedoch ist die Orientierung hin zu Neuentwicklungen und dem Willen, Produkte an Kundenbedürfnisse und -verfahren anzupassen.

Sitz der Gesellschaft:

Namics Corporation, Japan, 3993 Nigorikawa, Kita-ku, Niigata-City 950-3131, Japan

Europäisches Tochterunternehmen:

Namics Europe GmbH, Dietlindenstr. 15, 80802 München, Deutschland, Tel. 089/36036-730, Fax -700, info@namics-europe.com, www.namics-europe.com

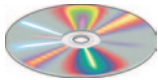


Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Greenwich	1./4.9.2008	ESTC 2008	IEEE/CPMT
Dresden	7./10.9.2008	EUROSENSORS	GMA/TU Dresden
Pultusk (60 km nach Warschau)	21./24.9.2008	32 nd International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference	IMAPS Poland & IEEE CPMT Poland
München	14./15.10.2008	IMAPS-Konferenz	IMAPS D
Denver/Co.	20./23.4.2009	5 th CICMT	IMAPS & ACerS

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2007*, die am 8./9. Oktober 2007 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiaerausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, und der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006 und 2007* zu den Themen *Muss jeder Sensor smart sein?* (Februar 2006 in Göppingen) und *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* (Februar 2007 in Ilmenau) sind noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die neu gestalteten Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Dr.-Ing. Jens Müller

jens.mueller@imaps.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

hans-ulrich.knipps@imaps.de

Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern findet man unter www.imaps.de (*Vorstand*)